

第一届“IC创新奖”获奖名单

技术创新奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	01-技术创新奖	01-设计	SDN高密度万兆以太网交换芯片GoldGate (CTC8096)	盛科网络(苏州)有限公司
2	01-技术创新奖	01-设计	面向安全应用的国产化CK802系列处理器	杭州中天微系统有限公司
3	01-技术创新奖	01-设计	千万门级自主知识产权FPGA器件 (PGT180H) 及其配套开发工具 (PDS)	深圳市紫光同创电子有限公司
4	01-技术创新奖	02-制造	55纳米SONOS嵌入式闪存技术	上海华力微电子有限公司
5	01-技术创新奖	02-制造	64Gb 32层三维存储器集成工艺及芯片设计技术	长江存储科技有限责任公司、中国科学院微电子研究所
6	01-技术创新奖	03-封测	硅基扇外型封装技术	华天科技(昆山)有限公司
7	01-技术创新奖	04-装备	12英寸铝磁控溅射设备	北京北方华创微电子装备有限公司
8	01-技术创新奖	04-装备	7纳米介质刻蚀设备	中微半导体设备(上海)有限公司
9	01-技术创新奖	05-材料	28nm集成电路用铜及铜阻挡层化学机械抛光液	安集微电子科技(上海)股份有限公司
10	01-技术创新奖	06-零部件	光刻机双工件台技术	清华大学、北京华卓精科科技股份有限公司

成果产业化奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	02-成果产业化奖	01-设计	低功耗DDR系列内存缓冲控制器	澜起科技(上海)有限公司
2	02-成果产业化奖	01-设计	全球首创玻璃盖板指纹芯片GF5126MA	深圳市汇顶科技股份有限公司
3	02-成果产业化奖	01-设计	中兴微电子多模数字中频芯片	深圳市中兴微电子技术有限公司
4	02-成果产业化奖	02-制造	40nm低功耗工艺	中芯国际集成电路制造有限公司
5	02-成果产业化奖	03-封测	12英寸硅通孔工艺国产集成电路制造关键设备与材料量产应用工程	苏州晶方半导体科技股份有限公司
6	02-成果产业化奖	03-封测	晶圆凸点及重布线晶圆级封装技术	江阴长电先进封装有限公司
7	02-成果产业化奖	04-装备	兆声波单片清洗机	盛美半导体设备有限公司
8	02-成果产业化奖	05-材料	130-28nm配线用超高纯金属溅射靶材	宁波江丰电子材料股份有限公司
9	02-成果产业化奖	05-材料	七一八所三氟化氮、六氟化钨等高纯电子气体	中国船舶重工集团公司第七一八研究所
10	02-成果产业化奖	06-零部件	干式真空泵	中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

产业链合作奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	03-产业链合作奖	01-设计	40-28nm国产工艺量产投片	海思半导体有限公司
2	03-产业链合作奖	01-设计	先进集成电路设计产业共性技术创新与平台化产品服务	中国科学院EDA中心
3	03-产业链合作奖	02-制造	65-28nm国产设备和材料的验证与应用	中芯国际集成电路制造有限公司
4	03-产业链合作奖	02-制造	国产集成电路材料量产应用	上海华虹宏力半导体制造有限公司

5	03-产业链合作奖	03-封测	通讯与多媒体芯片封装测试设备与材料应用	江苏长电科技股份有限公司、天水华天电子集团、通富微电子股份有限公司、深南电路股份有限公司
---	-----------	-------	---------------------	--

产业创新突出贡献奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖人	获奖单位
1	04-突出贡献奖	01-设计	杨崇和	澜起科技（上海）有限公司
2	04-突出贡献奖	02-制造	赵海军	中芯国际集成电路制造有限公司
3	04-突出贡献奖	03-封测	赖志明	江苏长电科技股份有限公司
4	04-突出贡献奖	04-装备	尹志尧	中微半导体设备（上海）有限公司
5	04-突出贡献奖	05-材料	姚力军	宁波江丰电子材料股份有限公司

第二届“IC创新奖”获奖名单

技术创新奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	01-技术创新奖	01-设计	100G高集成网络处理器芯片	深圳市中兴微电子技术有限公司
2	01-技术创新奖	01-设计	SPI NAND FLASH	北京兆易创新科技股份有限公司
3	01-技术创新奖	01-设计	多通道高速高精度16位125兆ADC芯片（BLAD16Q125）	上海贝岭股份有限公司
4	01-技术创新奖	01-设计	内置自研CPU处理器 LTE SOC（SC9850KH）芯片	北京紫光展锐科技有限公司
5	01-技术创新奖	01-设计	兆芯开先KX-6000系列处理器	上海兆芯集成电路有限公司
6	01-技术创新奖	02-制造	64层三维存储器集成工艺及芯片设计技术	长江存储科技有限责任公司、中国科学院微电子研究所
7	01-技术创新奖	03-封测	以硅通孔为核心的三维系统集成技术及应用	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
8	01-技术创新奖	04-装备	12英寸生产型PECVD设备（PF-300T）量产应用	沈阳拓荆科技有限公司
9	01-技术创新奖	04-装备	12英寸双脉冲刻蚀机NMC612D产品	北京北方华创微电子装备有限公司

成果产业化奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	02-成果产业化奖	01-设计	600V以上用于变频驱动的多芯片高压IGBT型智能功率模块	杭州士兰微电子股份有限公司
2	02-成果产业化奖	01-设计	Split Gate Trench MOSFET	华润微电子（重庆）有限公司
3	02-成果产业化奖	01-设计	华大九天EDA及相关服务	北京华大九天软件有限公司
4	02-成果产业化奖	03-封测	四边无引脚多圈新型QFN封装工艺技术研发及产业化	华天科技（西安）有限公司
5	02-成果产业化奖	04-装备	硅外延CVD设备研发及产业化	北京北方华创微电子装备有限公司
6	02-成果产业化奖	04-装备	中微Prismo A7 金属有机化合物气相沉积（MOCVD）设备	中微半导体设备（上海）股份有限公司

7	02-成果产业化奖	05-材料	电子级磷酸制备技术产业化应用	湖北兴福电子材料有限公司
产业链合作奖				
序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	03-产业链合作奖	01-设计	集成电路设计全产业链创新技术服务平台	中关村芯园（北京）有限公司
2	03-产业链合作奖	02-制造	12英寸国产装备和材料零部件开发与应用	武汉新芯集成电路制造有限公司
3	03-产业链合作奖	02-制造	6-8英寸集成电路材料国产化量产应用	无锡华润上华科技有限公司
4	03-产业链合作奖	03-封测	国产中道工艺高端封测装备与材料量产应用	苏州晶方半导体科技股份有限公司
产业创新突出贡献奖				
序号	奖励类型	技术类型	获奖人	获奖单位
1	04-突出贡献奖	01-设计	朱一明	北京兆易创新科技股份有限公司
2	04-突出贡献奖	02-制造	杨士宁	长江存储科技有限责任公司
3	04-突出贡献奖	03-封测	于燮康	国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟
4	04-突出贡献奖	04-装备	耿锦启	北方华创科技集团股份有限公司

第三届“IC创新奖”获奖名单

技术创新奖				
序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	01-技术创新奖	01-设计	高性能国产嵌入式CPU玄铁860	平头哥半导体有限公司
2	01-技术创新奖	01-设计	集成电路成品率提升EDA全流程软件系统及方法	杭州广立微电子有限公司
3	01-技术创新奖	01-设计	面向IC设计的高速高可靠全仿真系统	北京华大九天软件有限公司
4	01-技术创新奖	04-装备	12英寸Dual系列化学机械抛光（CMP）设备	华海清科股份有限公司
5	01-技术创新奖	04-装备	纳米量级三维形貌光学测量设备	深圳中科飞测科技有限公司
6	01-技术创新奖	05-材料	超大规模集成电路用过氧化氢	苏州晶瑞化学股份有限公司
7	01-技术创新奖	05-材料	卷带式高密度超薄柔性封装基板技术	安捷利电子科技（苏州）有限公司
8	01-技术创新奖	06-零部件	CS300压力不敏感气体质量流量控制器	北京七星华创流量计有限公司
成果产业化奖				
序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	02-成果产业化奖	01-设计	5G通信基站用宽带低噪声放大器	重庆西南集成电路设计有限责任公司
2	02-成果产业化奖	01-设计	屏下光学指纹识别芯片GW9518	深圳市汇顶科技股份有限公司
3	02-成果产业化奖	01-设计	支持北斗卫星的多模导航SOC单芯片	杭州中科微电子有限公司

4	02-成果产业化奖	03-封测	焊盘通孔全填充的12吋图像传感芯片WLCSP封装技术	华天科技（昆山）电子有限公司
5	02-成果产业化奖	04-装备	AccoTEST STS 8200模拟器件测试系统	北京华峰测控技术有限公司

产业链合作奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	03-产业链合作奖	02-制造	0.18微米BCD制造技术及应用	无锡华润上华科技有限公司、东南大学

产业创新突出贡献奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖人	获奖单位
1	04-突出贡献奖	02-制造	张昕	中芯国际集成电路制造有限公司
2	04-突出贡献奖	02-制造	朱慧珑	中国科学院微电子研究所
3	04-突出贡献奖	03-封测	曹立强	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

第四届“IC创新奖”获奖名单

技术创新奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	01-技术创新奖	01-设计	可重构计算芯片	北京清微智能科技有限公司
2	01-技术创新奖	02-制造	长江存储128层3D NAND闪存芯片（X2-9060和X2-6070）	长江存储科技有限责任公司、中国科学院微电子研究所
3	01-技术创新奖	04-装备	SPRUCE系列无图形晶圆表面缺陷光学检测设备	深圳中科飞测科技股份有限公司
4	01-技术创新奖	04-装备	量产型SACVD设备研发与应用	拓荆科技股份有限公司
5	01-技术创新奖	05-材料	12英寸集成电路先进制程用电子级氢氟酸关键技术研发与应用	中巨芯科技有限公司
6	01-技术创新奖	05-材料	集成电路用12英寸晶圆CMP氧化物用抛光垫	湖北鼎汇微电子材料有限公司

成果产业化奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	02-成果产业化奖	01-设计	高速电力线载波芯片研制及推广应用	北京智芯微电子科技有限公司
2	02-成果产业化奖	01-设计	高性能200万像素CMOS图像传感器芯片	格科微电子（上海）有限公司
3	02-成果产业化奖	01-设计	基于SDR架构的通用无线通信终端SoC芯片	中国信息通信科技集团宸芯科技有限公司
4	02-成果产业化奖	01-设计	芯动科技IP授权及相关服务	芯动科技（珠海）有限公司
5	02-成果产业化奖	03-封测	国产CPU封装测试全制程量产成套工艺成果转化	通富微电子股份有限公司
6	02-成果产业化奖	04-装备	8/12英寸晶圆槽式湿法清洗设备研制及产业化	上海至纯洁净系统科技股份有限公司
7	02-成果产业化奖	04-装备	应用于存储器领域的300mm立式氧化炉	北京北方华创微电子装备有限公司
8	02-成果产业化奖	05-材料	高纯六氟乙烷的研发及产业化	广东华特气体股份有限公司

产业链合作奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	03-产业链合作奖	02-制造	8英寸线成套国产装备和材料应用示范	北京燕东微电子有限公司
2	03-产业链合作奖	07-综合	产业链、创新链、金融链，“三链融合”推动半导体产业发展新模式	厦门半导体投资集团有限公司、开元通信技术（厦门）有限公司、厦门云天半导体科技有限公司、厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司、厦门通富微电子有限公司

产业创新突出贡献奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖人	获奖单位及职务
1	04-突出贡献奖	07-综合	魏少军	01专项技术总师
2	04-突出贡献奖	07-综合	叶甜春	02专项技术总师
3	04-突出贡献奖	02-制造	陈向东	杭州士兰微电子股份有限公司董事长
4	04-突出贡献奖	04-装备	王晖	盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事长

第五届“IC创新奖”获奖名单

技术创新奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	01-技术创新奖	设计	超低功耗单节锂电池电量计芯片(CW2217B)	广东赛微微电子股份有限公司
2	01-技术创新奖	设计	应用于SSD系统的高效高集成电源管理芯片	矽力杰半导体技术（杭州）有限公司
3	01-技术创新奖	设计	超高速宽频带模拟数字转换芯片	苏州迅芯微电子有限公司、中国科学院微电子研究所
4	01-技术创新奖	设计	车规级车身及发动机控制MCU芯片	苏州国芯科技股份有限公司
5	01-技术创新奖	设计	面向车载系统高清视频传输的国产化芯片组	天津瑞发科半导体技术有限公司
6	01-技术创新奖	制造	14 纳米产品工艺开发	中芯国际集成电路制造有限公司
7	01-技术创新奖	制造	22纳米超低漏电工艺技术(22ULL)	上海华力集成电路制造有限公司
8	01-技术创新奖	装备	12时常压硅外延设备开发	北京北方华创微电子装备有限公司
9	01-技术创新奖	装备	电子束缺陷检测设备(EBI)	东方晶源微电子科技（北京）有限公司
10	01-技术创新奖	材料	300mm大硅片技术研发	上海新昇半导体科技有限公司

成果产业化奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	02-成果产业化奖	设计	基于Cortex-M4内核32位高端通用MCU微控制器	北京兆易创新科技股份有限公司
2	02-成果产业化奖	设计	单芯片集成磁传感器	上海矽睿科技股份有限公司

3	02-成果产业化奖	设计	工业级电力双模近距离通信芯片	北京智芯微电子科技有限公司
4	02-成果产业化奖	设计	面向柔性显示的AMOLED驱动芯片	北京集创北方科技股份有限公司
5	02-成果产业化奖	制造	超高压智能功率驱动芯片工艺技术研发与产业化	无锡华润上华科技有限公司
6	02-成果产业化奖	装备	12吋化学机械抛光(CMP)装备	华海清科股份有限公司
7	02-成果产业化奖	装备	前道铜互连电镀设备	盛美半导体设备(上海)股份有限公司、上海华力集成电路制造有限公司
8	02-成果产业化奖	装备	12吋软焊料全自动装片机	大连佳峰自动化股份有限公司
9	02-成果产业化奖	材料	12吋集成电路用超高纯铜及其合金靶材量产应用	有研亿金新材料有限公司
10	02-成果产业化奖	材料	铜和铜阻挡层抛光液在130nm-14nm逻辑制程的产业化	安集微电子科技(上海)股份有限公司

产业链合作奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖项目	获奖单位
1	03-产业链合作奖	综合	GSEV 全球小型电动车平台芯片国产化应用	上汽通用五菱汽车股份有限公司
2	03-产业链合作奖	材料	3D NAND 先进制程用高选择比氮化硅蚀刻液(HSO)研发与工艺应用	长江存储科技有限责任公司、上海新阳半导体材料股份有限公司

产业创新突出贡献奖

序号	奖励类型	技术类型	获奖人	获奖单位
1	04-突出贡献奖	封测	王新潮	江苏新潮创新投资集团有限公司
2	04-突出贡献奖	封测	石明达	通富微电子股份有限公司
3	04-突出贡献奖	封测	肖胜利	天水华天电子集团
4	04-突出贡献奖	材料	王淑敏	安集微电子科技(上海)股份有限公司